

自動車用先端 S o C 技術研究組合、imec との戦略的連携を発表 —自動車向けチップレット技術の共有アーキテクチャの仕様策定を目指す—

チップレット技術を適用した高性能デジタル半導体（System on Chip/以下、SoC）の車載化研究開発をおこなう「自動車用先端 SoC 技術研究組合（Advanced SoC Research for Automotive/以下、ASRA）」は、ベルギーの半導体研究機関である「imec（アイメック）」と 2025 年 11 月 10 日、戦略的連携に合意しました。今後、imec が設立したアライアンス組織「自動車向けチップレットプログラム（Automotive Chiplet Program/ 以下、ACP）」（<https://www imec-int.com/en/expertise/cmos-advanced-and-beyond/compute/automotive-chiplet-program>）を通じて、共有アーキテクチャ仕様の共同調査を推進していきます。

今後 ASRA は imec と連携し、2026 年半ばまでに双方の研究成果から導いた共通仕様を策定し公開することを目指します。

各機関コメント

川原 伸章 ASRA 専務理事：imec と ASRA で、自動車向けチップレットに関する新しい要求仕様書（「共同文書」）を共同で作成・公開することになりました。この協業は、imec の ACP パートナーおよび ASRA メンバー双方に利益をもたらし、将来の業界標準化を支援します。現在、OEM 毎に異なるパワートレイン、車のバリエーションがあり、異なる電子プラットフォームがあり、これらに対し、チップの組み合わせで、電子プラットフォームに最適な SoC を提供することが出来る様になります。このパートナーシップは素晴らしい成果をもたらし、将来の自動車用チップレットのエコシステムの実現につながると確信しております。

パート・ブラックレー VP Automotive, imec：「ACP と ASRA はチップレット技術の相互運用性・信頼性・スケーラビリティの向上を促進することで、チップレット技術の導入加速とリスク低減を目指すという共通の目標を掲げています。両者が、アーキテクチャ仕様の策定を進めることで、私たちのパートナー企業は、彼らが開発する技術に拡張性や信頼性を担保することができ、実環境での導入加速に寄与すると確信しています。そして、私たちの取り組みは、全てのステークホルダーに利益をもたらし、業界全体に良い効果を広げることを期待しています。」

自動車用先端 SoC 技術研究組合の概要

設立日	2023 年 12 月 1 日
理事長	山本 圭司
専務理事	川原 伸章
組合員 (50 音順)	<p>自動車メーカー : スズキ株式会社、株式会社 SUBARU、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、本田技研工業株式会社、マツダ株式会社</p> <p>電装部品メーカー : Astemo 株式会社、株式会社デンソー、パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社</p> <p>半導体関連企業 : 株式会社ソシオネクスト、日本ケイデンス・デザイン・システムズ社、日本シノプシス合同会社、株式会社ミライズテクノロジーズ、ルネサスエレクトロニクス株式会社</p>
本部所在地	愛知県名古屋市西区那古野二丁目 14 番 1 号 なごのキャンパス内
事業内容	チップレット技術を適用した自動車用 SoC の研究開発

<お問い合わせ>

ASRA 事業管理部

Mail : asracip_info@asra.jp

Web : <https://asra.jp/>

以上